

杭州士兰微电子股份有限公司

关于子公司成都士兰半导体制造有限公司增资完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、增资概述

杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020 年 10 月 15 日召开了第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于全资子公司成都士兰半导体制造有限公司增资并签署相关协议的议案》：

公司全资子公司成都士兰半导体制造有限公司（以下简称“成都士兰”）因推进业务发展的需要，新增注册资本 19,000 万元（以下简称“本次增资”）。四川省集成电路和信息安全产业投资基金有限公司（以下简称“四川省产业基金”）和阿坝州振兴产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“阿坝州产业基金”）共同出资 19,000 万元，全额认购本次成都士兰新增的注册资本，其中：四川省产业基金以货币方式认缴出资 15,000 万元，占增资后成都士兰注册资本的 15%；阿坝州产业基金以货币方式认缴出资 4,000 万元，占增资后成都士兰注册资本的 4%。本次增资无溢价。本次增资完成后，成都士兰的注册资本由 81,000 万元增加至 100,000 万元。

上述事项详见公司于 2020 年 10 月 16 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和《上海证券报》、《中国证券报》及《证券时报》上披露的《关于全资子公司成都士兰半导体制造有限公司增资并签署相关协议的公告》（公告编号：临 2020-055）。

二、增资完成情况

1、四川省产业基金和阿坝州产业基金已于近日分别完成了本次增资的全部增资款的缴纳事项，成都士兰的股权结构及实收资本情况如下所示：

股东名称	认缴注册资本（万元）	实缴注册资本（万元）	持股比例（%）
杭州士兰微电子股份有限公司	81,000	81,000	81.00
四川省集成电路和信息安全产业投资基金有限公司	15,000	15,000	15.00

阿坝州振兴产业发展股权投资 基金合伙企业（有限合伙）	4,000	4,000	4.00
合计	100,000	100,000	100.00

2、成都士兰已于近日办理完成工商变更登记手续，并取得了金堂县行政审批局颁发的新营业执照，基本情况如下：

名称：成都士兰半导体制造有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：四川省成都市金堂县淮口街道成都-阿坝工业集中发展区士芯路9号

法定代表人：陈向东

注册资本：壹拾亿元整

成立日期：2010年11月18日

营业期限：2010年11月18日至2030年11月17日

经营范围：集成电路、半导体分立器件、发光半导体等半导体产品的设计、制造、销售及相关技术转让；相关的原材料、机械设备的销售（经向环保部门排污申报后方可经营）；货物进出口和技术进出口。（法律、法规禁止经营的项目除外，法律、法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。

特此公告！

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2020年11月13日